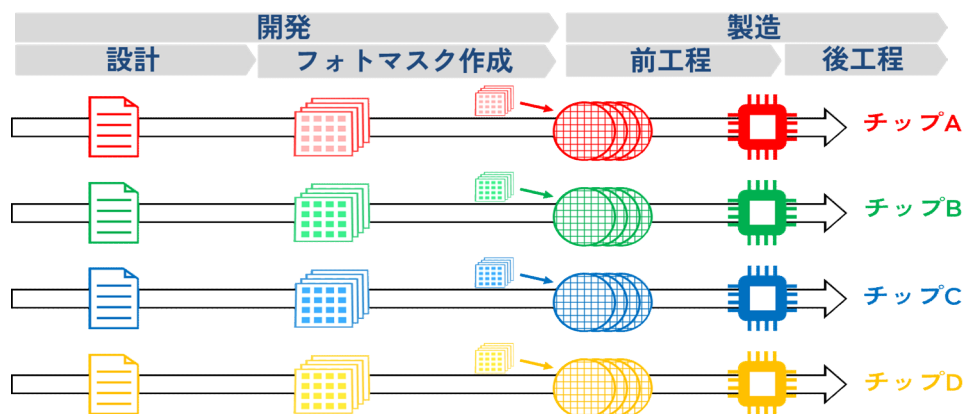


共通回路×配線で仕様を決める モジュラー型ICアーキテクチャ「LDIC」

-少量多品種・短納期でも現実的なIC設計・評価・量産判断の進め方-

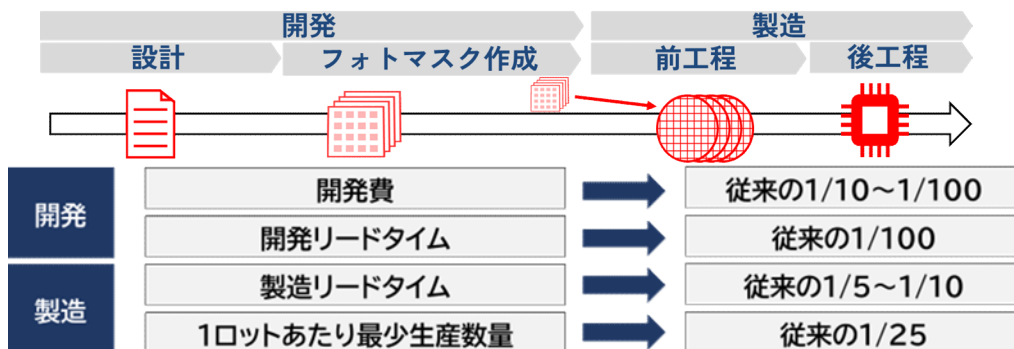
「共通回路 × 配線で仕様を決める モジュラー型ICアーキテクチャ」

◆従来の半導体設計の課題



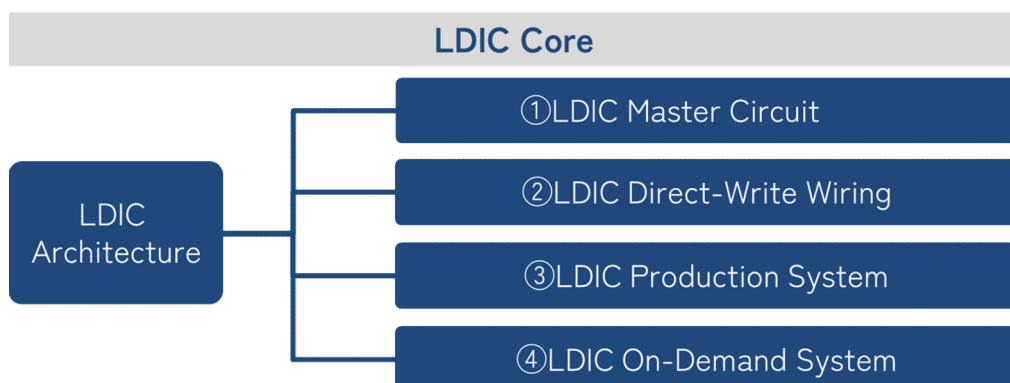
- ✓ 高コスト
- ✓ 長期間
- ✓ 少量多品種
では成立しにくい

◆LDICのアプローチ(従来 vs LDIC)



- ✓ 開発費用
- ✓ 開発期間
- ✓ 製造期間
- ✓ 生産数量
の制約を緩和

◆LDIC を構成する4つの要素



- ✓ 設計
- ✓ 評価
- ✓ 製造
を分断せずに
つなぐ4つの要素